

П А С П О Р Т

3.402.020 ПСИ

Микросхема типа К217ЛБ2А К217ЛБ2Б соответствует
техническим условиям 6К0.348.011 ТУ

1. Функциональное назначение—логическая схема „И-НЕ/ИЛИ-НЕ“

2. Режим работы:

—напряжение питания:

 $E_1 - В$ $E_2 - В$ P_n —потребляемая мощность от источника питания: $E_1 - мВт$ $E_2 - мВт$ 3. Основные электрические параметры при $T = +25 \pm 10^\circ C$ $I_{вх}$ —входной ток, мА $I_{з. вых}$ —выходной ток закрытой микросхемы, мкА не более $U_{в}$ —верхний уровень выходного напряжения, В не более $U_{н}$ —нижний уровень выходного напряжения, В, не более $t_{3^{10}}$ —время задержки распространения на включение, нс, не более $t_{3^{01}}$ —время задержки распространения на включение, нс, не более

нагрузочная способность на каждый выход:

К217ЛБ2А—4 микросхемы К217ЛБ1

К217ЛБ2Б—6 микросхем К217ЛБ1

коэффициент объединения по коллектору, не более

количество входов по схеме „И“

4. Указание содержания драгоценных металлов: см. штамп „Содержит драгметаллы“.

5. Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации:

а) Рекомендации по лужению методом погружения в расплавленный припой:

температура расплавленного припоя, $^\circ C$,

время погружения, с,

расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм,

допустимое количество погружений,

интервал между двумя погружениями, мин.

припой и флюсы—по нормали НО.054.063

б) Рекомендации по установке:

Установку микросхем на плату производят с зазором $1 \pm 0,5$ мм. Крепление микросхем к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом припайки к выводам без какого-либо механического крепления.

в) Рекомендации по пайке микросхем одножальным паяльником:

температура жала паяльника, $^\circ C$,

время касания каждого вывода, с,

расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм.

интервал между пайками соседних выводов, с,

Жало паяльника должно быть заземлено.

г) Рекомендации по групповой пайке:

температура расплавленного припоя $^\circ C$.

время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы), с,

расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм.

интервал между двумя повторными пайками выводов, мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: При пайке или сварке выводов следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

д) Рекомендации по очистке от флюса, влагозащите:

рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с нормалью НО.054.063;

рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231, МРТУ 6-10-863-69, или Э-4100

МРТУ 6-10-857-69.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для очистки от флюса и влагозащиты микросхем допускается применять любые другие моющие жидкости и лаки, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку и материал корпуса, после согласования со специализированной организацией по применению интегральных микросхем и проведения соответствующих испытаний.

6. Условия эксплуатации

—температура окружающей среды от $-45^\circ C$ до $+70^\circ C$;—относительная влажность воздуха 98% при температуре $T = +25^\circ C$;—вибрация с ускорением до $10g$ в диапазоне частот от 1 до $600 Гц$;—многократные удары с ускорением до $75g$;—линейные (центробежные) ускорения до $25g$;

7. Время наработки—10 000 час.

8. Срок хранения 6 лет.

Содержание

в приборе

Серебра 3,000072

Золота 0,0009778

Палладия 0,000083

 $6,0 \pm 10\%$ $3,0 \pm 10\%$

26

14,6

 $1,7 - 2,1$

1

2,6

0,3

12

35

 8×2 3×2

250

2

1

2

5

280

3

1

10

265

3

1

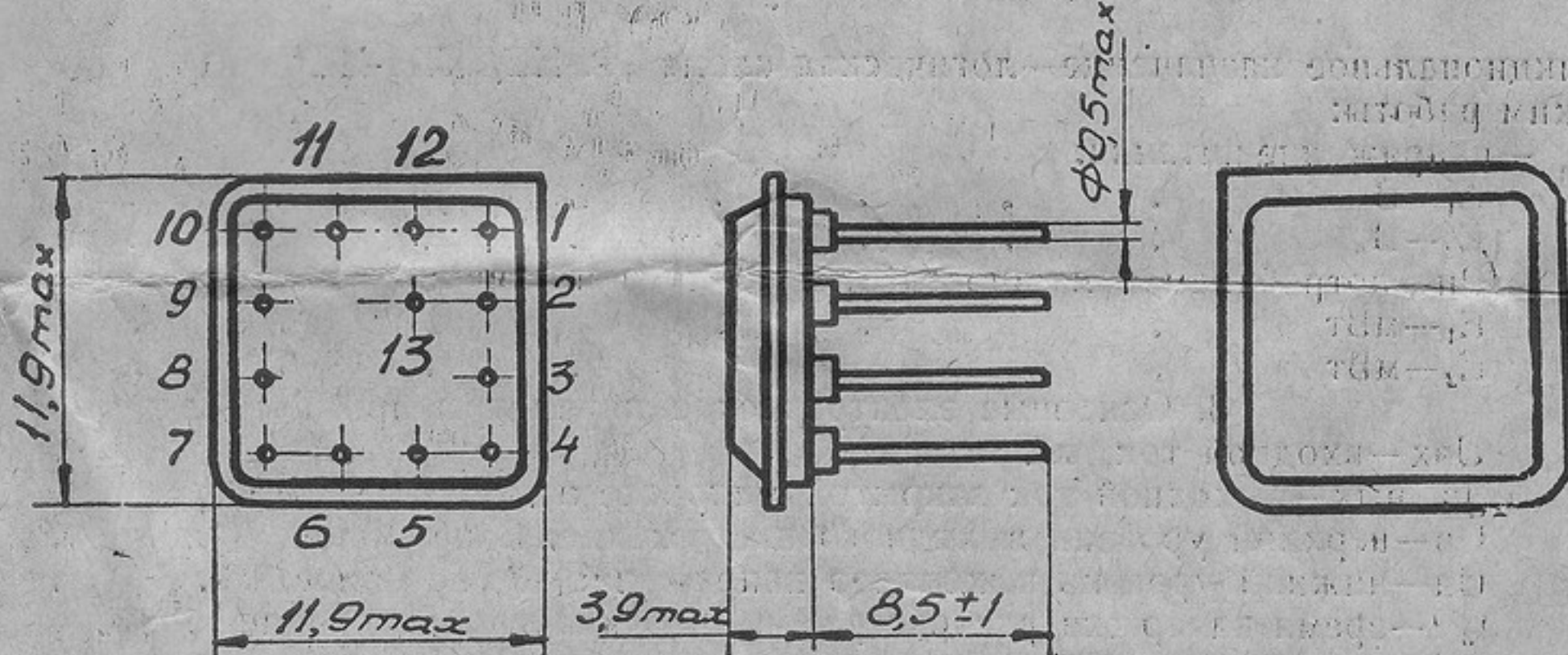
5

9. Гарантий предприятия-изготовителя.

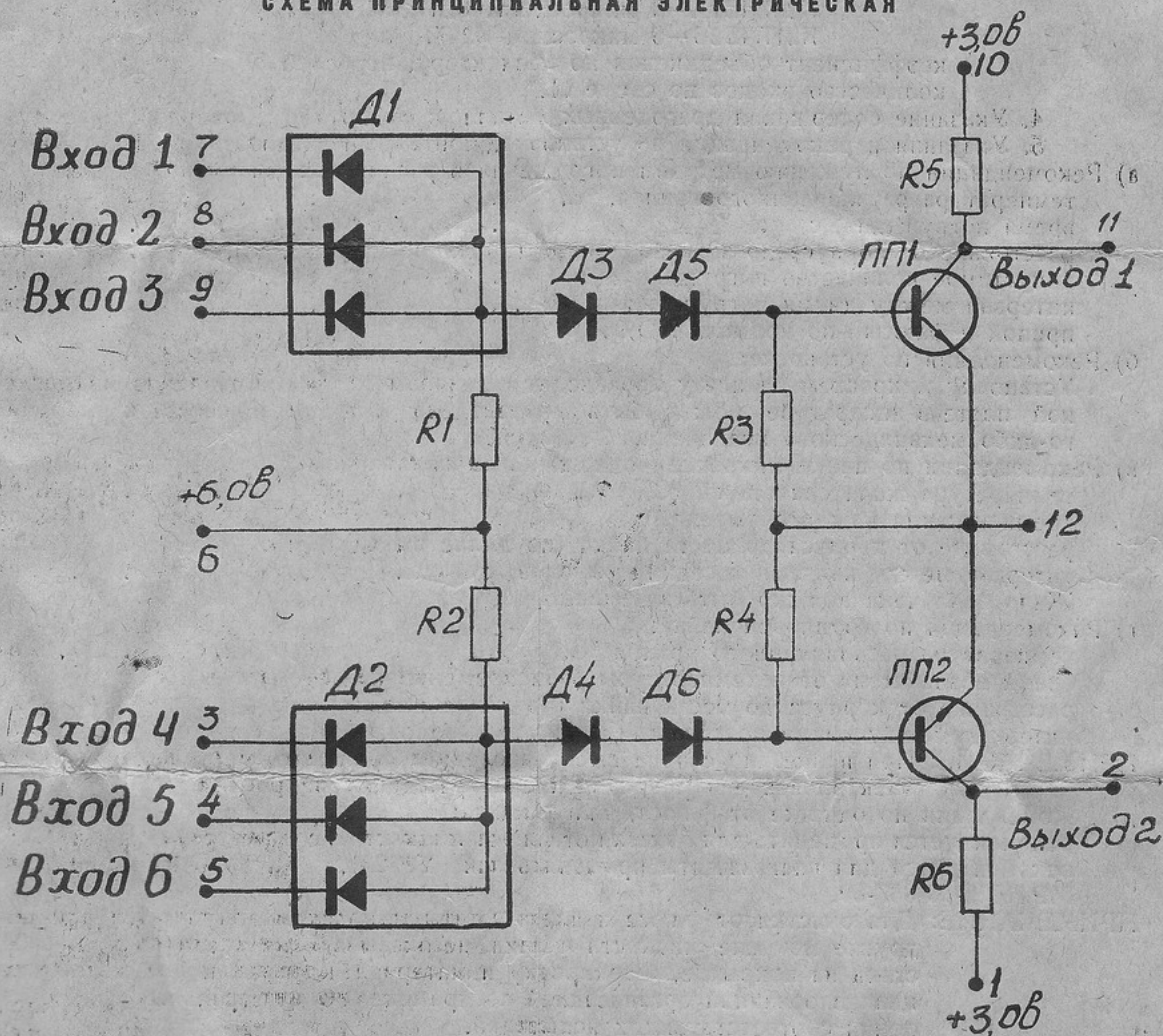
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставляемой микросхемы всем требованиям ГОСТ 18725—73 и ТУ в течение срока сохраняемости или наработки при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации установленных ГОСТ 18725—73 и ТУ.

Срок гарантии исчисляется со дня отгрузки микросхем потребителю.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса микросхемы не более 1.5 г.
СХЕМА ПРИНЦИПАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



$R1, R2 = 3.0 \text{ кОм} \pm 5\%$

$R3, R4 = 7.0 \text{ кОм} \pm 20\%$

$R5, R6 = 1.5 \text{ кОм} \pm 10\%$

Вариант I Д1, Д2—Диодная матрица 2Д910В

Вариант I Д3—Д6—Диодная матрица 2Д911А

Вариант II Д1, Д2—Диодная матрица 2Д912А

Вариант II Д3—Д6—Диодная матрица 2Д912Б

Вариант I ПП1, ПП2—Транзистор кремниевый 2Т318Б или 2Т318В
Вариант II ПП1, ПП2—Транзистор кремниевый 2Т333Б или 2Т333В.

Вариант II обозначается треугольником цвета маркировки

Дата выпуска

ШТАМП ОТК

ФЕВРАЛЬ